

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. November 2005 (03.11.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/103729 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01R 1/04**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE2005/000714**

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. April 2005 (19.04.2005)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 020 187.0 22. April 2004 (22.04.2004) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **INFINEON TECHNOLOGIES AG** [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **OSSIMITZ, Peter**
[AT/DE]; Gilmstr. 58 A, 81377 München (DE).

(74) Anwalt: **SCHWEIGER, Martin**; c/o Kanzlei Schweiger
& Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).

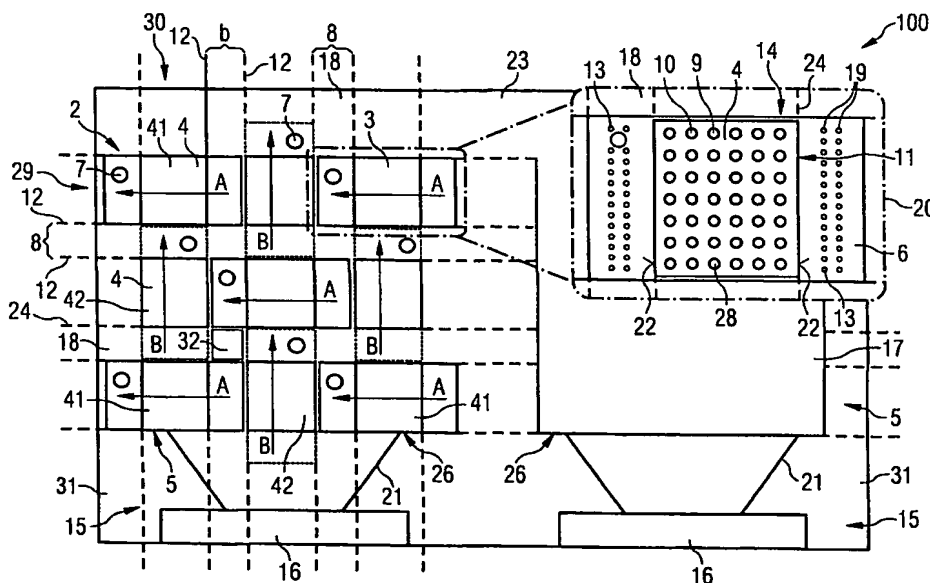
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,
MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM,
PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU,
ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **REWIRING SUBSTRATE STRIP WITH SEVERAL SEMICONDUCTOR COMPONENT POSITIONS**

(54) Bezeichnung: **UMVERDRAHTUNGSSUBSTRATSTREIFEN MIT MEHREREN HALBLEITERBAUTEILPOSITIONEN**



(57) Abstract: The invention relates to a rewiring substrate strip (100) with several semiconductor component positions (2) for semiconductor components (3). The semiconductor component positions (2) are arranged in rows and columns. Several semiconductor component positions are combined to form a component group (5). The semiconductor components (3) of a component group (5) are arranged in relation to each other, such that a single semiconductor component (3) is turned 90° in relation to four adjacent semiconductor components.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/103729 A1



PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Der Umverdrahtungssubstratstreifen (100) weist mehrere Halbleiterbauteilpositionen (2) für Halbleiterbauteile (3) auf. Die Halbleiterbauteilpositionen (2) sind in Zeilen und Spalten angeordnet. Dabei sind mehrere Halbleiterbauteilpositionen zu einer Bauteilgruppe (5) zusammengefasst. Die Halbleiterbauteile (3) einer Bauteilgruppe (5) sind derart zueinander angeordnet, dass ein einzelnes Halbleiterbauteil (3) gegenüber vier benachbarten Halbleiterbauteilen um 90° gedreht ist.